

100% nagelneu und hohe Qualität!!

Rosin Flussmittel wird verwendet, um das Lötén zu erleichtern.

Es reinigt und verhindert eine Metalloxidation, wodurch das Lötmittel starke, lang anhaltende mechanische und elektrische Verbindungen erzeugt.

Es wirkt auch als Benetzungsmittel, erhöht den Fluss von Lot und die Effizienz des Lötprozesses.

Perfekt für Mobiltelefone, PC-Karten und andere anspruchsvolle elektronische Chip-Ebene Flussmittelschweißen.

Spezifikationen

Produkt: BST-706

Schmelzpunkt: 138 °C

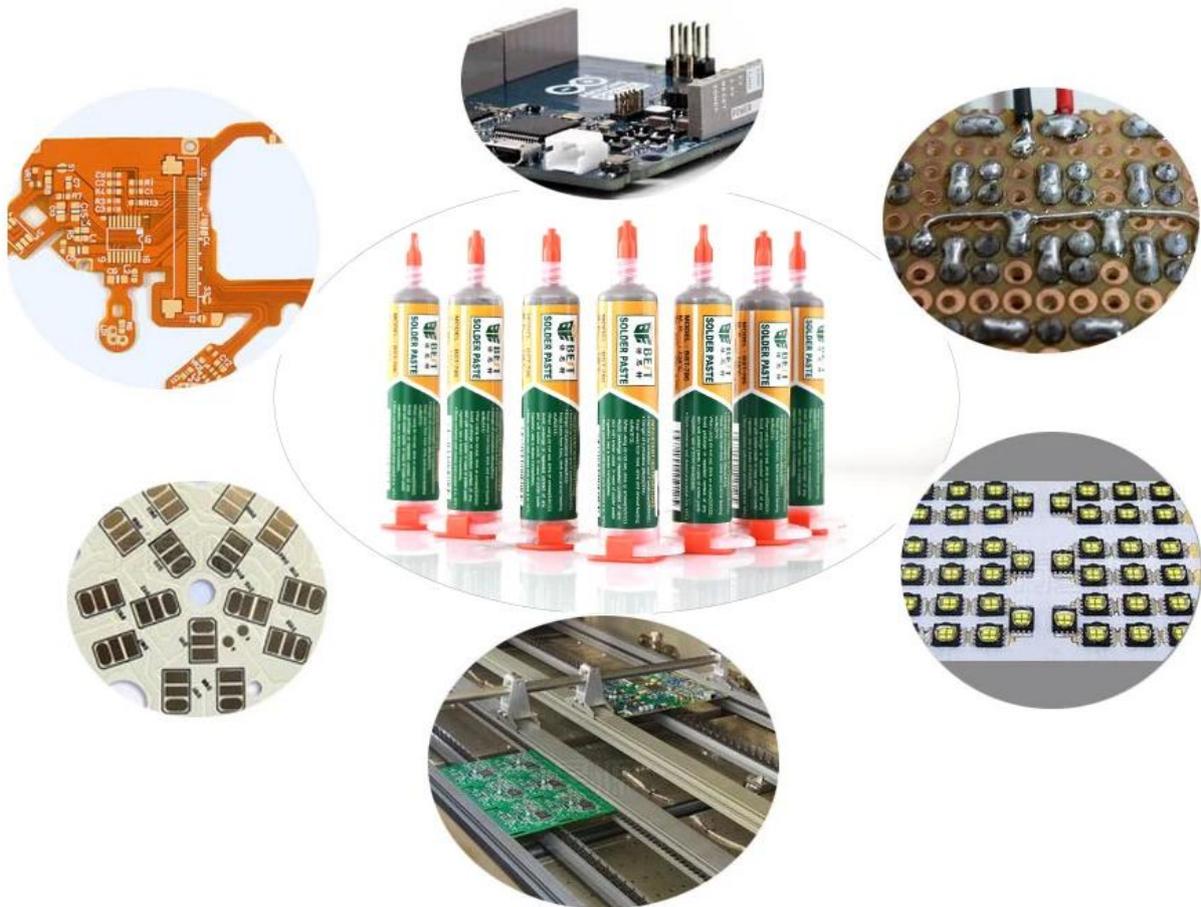
Volumen: 10cc

Gewicht: 38g

Zutaten: Sn99%, Cu0,7%, Ag0,3%

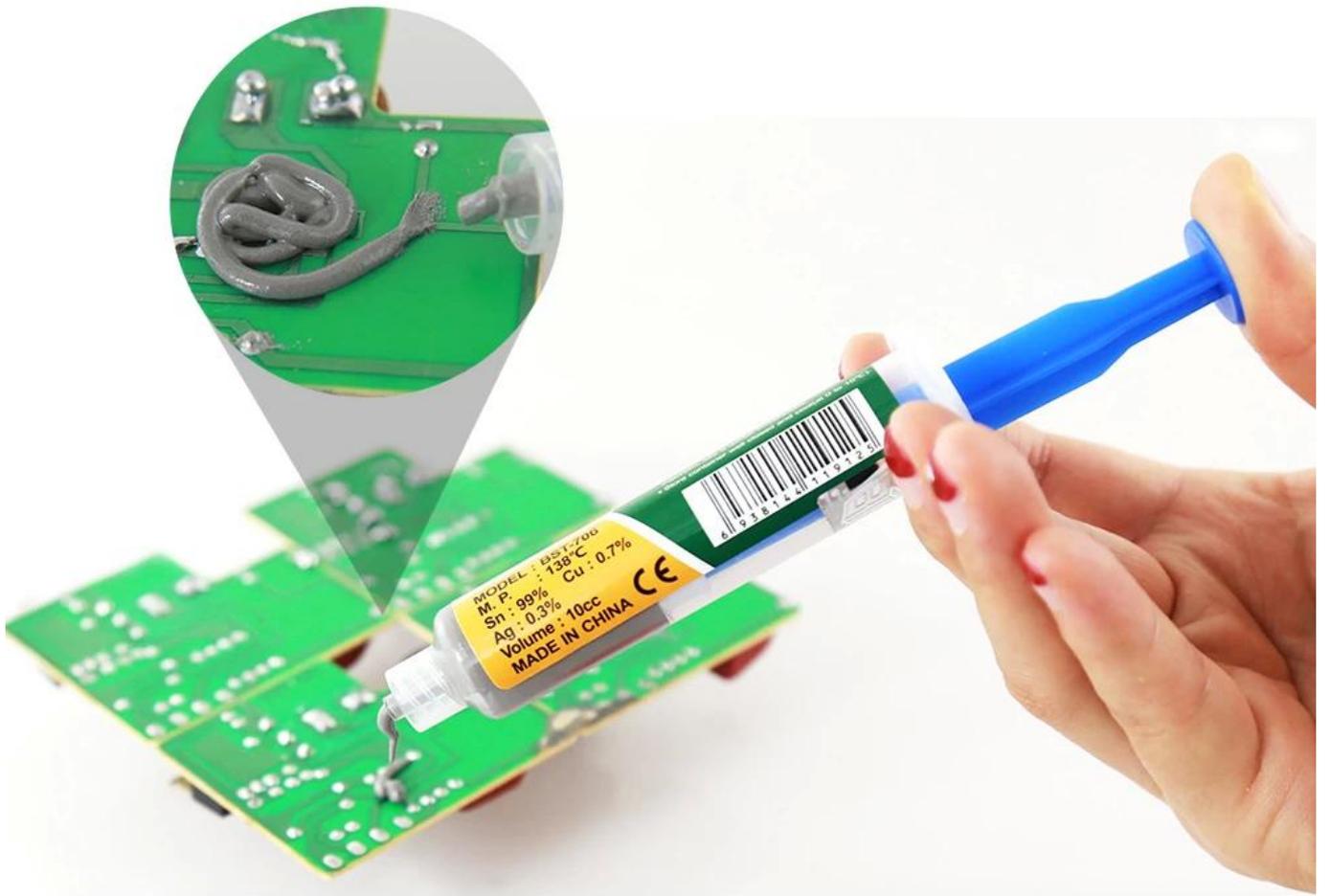
## PRODUCT USAGE

---



# PRODUCT SIZE





Brand: BEST

Model Number:706

Melting point:138°C

Ingredients: Sn99% Cu0.7% Ag0.3%

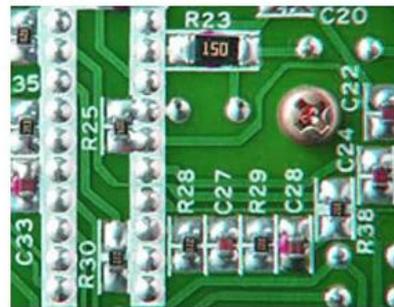
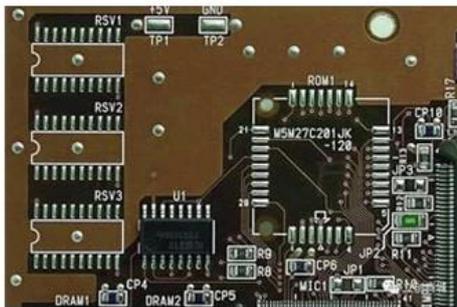
Volume:10cc

Weight: 38g

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



# PRODUCT PHOTOGRAPH





**BFBEL**  
SOLDER PASTE  
MODEL: BS2706  
M.P. 138°C  
Sn 62%  
Pb 36%  
Cu 1.7%

**BFBEL**  
SOLDER PASTE  
MODEL: BS2706  
M.P. 138°C  
Sn 62%  
Pb 36%  
Cu 1.7%

**BFBEL**  
SOLDER PASTE  
MODEL: BS2706  
M.P. 138°C  
Sn 62%  
Pb 36%  
Cu 1.7%

**BFBEL**  
SOLDER PASTE  
MODEL: BS2706  
M.P. 138°C  
Sn 62%  
Pb 36%  
Cu 1.7%

**BFBEL**  
SOLDER PASTE  
MODEL: BS2706  
M.P. 138°C  
Sn 62%  
Pb 36%  
Cu 1.7%